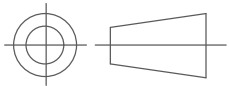
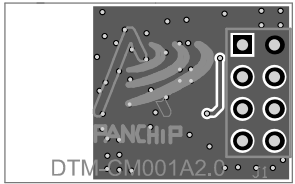


1			2			3			4				
A	CHECK LIST								板材	FR-4	器件	13	
	结构工程师核对内容								板层	双面	网络	14	
	1. PCB中是否所有器件都有3D模型								工艺	喷锡	过孔	49	
	2. 是否有生成PCB的3D模型给结构进行装配								铜厚	35u	孔	57	
	3. 结构是否确认所有器件与外壳不干涉								颜色	绿色	焊盘	53	
	4. PCB板厚、外形及开孔公差是否满足要求								由板厂按最优方案拼板后，将拼板文件电子档发给研发和工艺确认并存档				
5. PCB板厚、外形公差特殊要求是否标出													
B	硬件工程师核对内容												
	1. 原理图网络和PCB网络是否完全匹配												
	2. 最小线宽是否大于或等于0.15mm												
	3. 所有电源网络走线是否有双过孔												
	4. 所有大于100mA电流的走线是否有双过孔												
	5. 布局是否合理，后焊间距是否为1mm												
	6. 电源回路，地回路是否足够宽和最短												
	7. 过孔属性是否全为盖油												
C	8. PCB上是否锅仔片或导电硅胶按键												
	D												



上海磐启微电子有限公司

外型公差: $\pm 0.1\text{mm}$

注意事项:

板厚公差:

$$0.4-0.8 \pm 0.08\text{mm}$$

1. 0-2. 0 \pm 10%

V-CUT对位精度:

 $\pm 0.1\text{ mm}$

V-CUT深度:1/3板厚

单

位

mm

图层

底层

第 2 页 共 2 页